



Soitec annonce une collaboration importante pour le développement d'une technologie d'intégration 3D au niveau des plaques

BERNIN, France —14 juillet 2009 — Soitec (Euronext Paris), premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI) et autres substrats innovants utilisés en microélectronique, annonce ce jour une collaboration avec IBM portant sur l'utilisation de procédés de collage et la création de substrats pour les nœuds inférieurs à 22 nanomètres (nm). Ces techniques permettront de développer une technologie d'intégration 3D au niveau des plaques pour les circuits intégrés de nouvelle génération. Les deux sociétés collaborent depuis de nombreuses années en vue d'améliorer la conception et les spécifications de substrats avancés, conformément à la feuille de route définie par IBM dans le domaine de la production.

Ce nouveau partenariat a pour objectif de développer des solutions extrêmement flexibles et à coût optimisé pour l'empilement de plaques (*wafer-to-wafer*), une technologie microélectronique permettant de réaliser des circuits intégrés plus rapides et plus performants.

Soitec mettra sa technologie Smart Stacking™ au service des initiatives prises par IBM dans le domaine de l'intégration 3D. Elle lui apportera aussi l'expertise acquise dans le domaine du collage au niveau des plaques, y compris le collage par adhésion moléculaire oxyde sur oxyde et métal sur métal, développées en collaboration avec le CEA/Léti.

« Cet accord avec Soitec est une nouvelle étape dans la course à l'accélération de la technologie d'intégration 3D et renforce l'écosystème d'IBM composé d'entreprises de pointe et d'organismes de recherche parmi les meilleurs, qui travaillent ensemble pour réaliser des avancées significatives dans le domaine des semi-conducteurs et des nanotechnologies », déclare Dr. Gary Patton, Vice Président IBM, Semiconductor Research and Development Center. *« Au travers de ces partenariats, IBM entend accélérer le développement de la technologie émergente d'intégration 3D et démontrer que cette intégration verticale permet d'augmenter la densité des circuits, d'atteindre des vitesses plus élevées et de réduire la consommation d'énergie ».*

« Depuis 15 ans, Soitec soutient les programmes de développement d'IBM avec le SOI et ses substrats innovants. Nous sommes convaincus que cette nouvelle collaboration aidera IBM à relever les défis rencontrés dans le cadre de son programme d'intégration 3D », a pour sa part déclaré Carlos Mazuré, Directeur R&D de Soitec.

À propos de Soitec

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence



ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie Smart Stacking™ de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr.

Soitec, Smart Cut, Smart Stacking et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

Relations Presse – H&B Communication

Marie-Caroline Saro – Tel. +33 (0)1 58 18 32 44 – Mob. +33 6 70 45 74 37

Claire Flin – Tel. +33 (0)1 58 18 32 53 – Mob. +33 6 82 92 94 47

Email : mc.saro@hbcommunication.fr